

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第6262703号  
(P6262703)

(45) 発行日 平成30年1月17日(2018.1.17)

(24) 登録日 平成29年12月22日(2017.12.22)

(51) Int.Cl.

F 1

G06F 3/044 (2006.01)  
G06F 3/041 (2006.01)G06F 3/044 140  
G06F 3/041 410  
G06F 3/041 600

請求項の数 6 (全 25 頁)

(21) 出願番号 特願2015-219873 (P2015-219873)  
 (22) 出願日 平成27年11月9日 (2015.11.9)  
 (62) 分割の表示 特願2015-124247 (P2015-124247)  
 原出願日 平成27年6月19日 (2015.6.19)  
 (65) 公開番号 特開2016-40734 (P2016-40734A)  
 (43) 公開日 平成28年3月24日 (2016.3.24)  
 審査請求日 平成27年11月10日 (2015.11.10)  
 審判番号 不服2016-18443 (P2016-18443/J1)  
 審判請求日 平成28年12月8日 (2016.12.8)  
 (31) 優先権主張番号 10-2014-0098917  
 (32) 優先日 平成26年8月1日 (2014.8.1)  
 (33) 優先権主張国 韓国 (KR)

早期審査対象出願

(73) 特許権者 513009370  
 株式会社 ハイディープ  
 Hi Deep Inc.  
 大韓民国、ギヨンギード・463-400  
 、ソナムー、ブンダン-グ、ダエワン  
 パンギヨーロ・644・ペオン-ギル、4  
 9、ダサン・タワー・3エフ  
 3F Dasan Tower, 49, D  
 aewangpangyo-ro 644  
 beon-gil, Bundang-g  
 u, Seongnam-si, Gyeon  
 gg i-do 463-400, Repu  
 blic of Korea  
 (74) 代理人 100114188  
 弁理士 小野 誠

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】スマートフォン

## (57) 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

基板及びディスプレイモジュールを含むタッチ入力装置に付着されて使用され、前記タッチ入力装置に印加される圧力を検出するための、平面形態を有する電極シートであって、前記電極シートは、

第1電極及び第2電極、及び

前記第1電極及び前記第2電極を挟んで位置し、前記第1電極及び前記第2電極の上面及び下面で互いに重なって前記第1電極及び前記第2電極を覆うように平面形態を有する第1絶縁層と第2絶縁層、

を含み、

前記タッチ入力装置は、

前記電極シートと離隔して前記電極シートと垂直方向に重なるように位置する基準電位層と前記電極シートとの間の相対的な距離変化によって変わる、前記第1電極と前記第2電極との間の静電容量を検出し、

前記電極シートを前記静電容量の変化によって前記距離変化を引き起こす前記圧力の大きさを検出することができるよう前記タッチ入力装置の互いに向かい合う前記基板の一面と前記ディスプレイモジュールの一面の何れか一方に付着させ、

前記ディスプレイモジュールは、ディスプレイパネルを含み、

前記基板は、前記ディスプレイモジュールの下部に前記ディスプレイモジュールと離隔して配置され、

10

20

前記基板は、バッテリー及び回路基板のうちの少なくとも一つの実装空間を前記ディスプレイモジュールから分離するか、又は前記ディスプレイモジュールから発生するノイズを遮蔽するように構成された部材であり、

前記圧力が印加されれば前記ディスプレイモジュールが撓み、

前記ディスプレイモジュールが撓むことによって前記電極シートと前記基準電位層との間の距離が変わり、

前記基板と前記ディスプレイモジュールのうち前記電極シートが付着されない残りの一つが前記基準電位層である、電極シート。

#### 【請求項 2】

基板及びディスプレイモジュールを含むタッチ入力装置に付着されて使用され、前記タッチ入力装置に印加される圧力を検出するための、平面形態を有する電極シートであつて、前記電極シートは、

電極、及び

前記電極を挟んで位置し、前記電極の上面及び下面で互いに重なって前記電極を覆うように平面形態を有する第1絶縁層と第2絶縁層、

を含み、

前記タッチ入力装置は、

前記電極シートと離隔して前記電極シートと垂直方向に重なるように位置する基準電位層と前記電極シートとの間の相対的な距離変化によって変わらる、前記電極と前記基準電位層との間の静電容量を検出し、

前記電極シートを前記静電容量の変化によって前記距離変化を引き起こす前記圧力の大きさを検出することができるように前記タッチ入力装置の互いに向かい合う前記基板の一面と前記ディスプレイモジュールの一面の何れか一方に付着させ、

前記ディスプレイモジュールは、ディスプレイパネルを含み、

前記基板は、前記ディスプレイモジュールの下部に前記ディスプレイモジュールと離隔して配置され、

前記基板は、バッテリー及び回路基板のうちの少なくとも一つの実装空間を前記ディスプレイモジュールから分離するか、又は前記ディスプレイモジュールから発生するノイズを遮蔽するように構成された部材であり、

前記圧力が印加されれば前記ディスプレイモジュールが撓み、

前記ディスプレイモジュールが撓むことによって前記電極シートと前記基準電位層との間の距離が変わり、

前記基板と前記ディスプレイモジュールのうち前記電極シートが付着されない残りの一つが前記基準電位層である、電極シート。

#### 【請求項 3】

前記第1電極及び前記第2電極の少なくとも何れか一つは複数の電極を含んで構成される、請求項1に記載の電極シート。

#### 【請求項 4】

前記複数の電極は、複数のチャネルを構成する、請求項3に記載の電極シート。

#### 【請求項 5】

前記電極は、複数の電極を含んで構成される、請求項2に記載の電極シート。

#### 【請求項 6】

前記複数の電極は、複数のチャネルを構成する、請求項5に記載の電極シート。

#### 【発明の詳細な説明】

#### 【技術分野】

#### 【0001】

本発明は、スマートフォンに関するもので、より詳しくは、ディスプレイモジュールを含むスマートフォンとして、タッチ位置及びタッチ圧力の大きさを検出できるように構成されたスマートフォンに関する。

#### 【背景技術】

10

20

30

40

50

**【0002】**

コンピューティングシステムの操作のために、多様な種類の入力装置が用いられている。例えば、ボタン(button)、キー(key)、ジョイスティック(joystick)、及びタッチスクリーンのような入力装置が用いられている。タッチスクリーンの手軽で簡単な操作により、コンピューティングシステムの操作時にタッチスクリーンの利用が増加している。

**【0003】**

タッチスクリーンは、タッチ・感應表面(touch-sensitive surface)を備えた透明なパネルであり得るタッチセンサパネル(touch sensor panel)を含むタッチ入力装置のタッチ表面を構成することができる。このようなタッチセンサパネルはディスプレイスクリーンの前面に付着され、タッチ・感應表面がディスプレイスクリーンの見える面を覆うことができる。使用者が指などでタッチスクリーンを単純にタッチすることによって、使用者がコンピューティングシステムを操作することができるようになる。一般的に、コンピューティングシステムは、タッチスクリーン上のタッチ及びタッチ位置を認識して、このようなタッチを解釈することによって、これに従い演算を遂行することができる。

**【0004】**

この時、ディスプレイモジュールの性能を低下させないながらも、タッチスクリーン上のタッチによるタッチ位置だけでなく、タッチ圧力の大きさを検出できるタッチ入力装置に対する必要性が生じている。

10

20

**【発明の概要】****【発明が解決しようとする課題】****【0005】**

本発明の一実施形態では、タッチスクリーン上のタッチの位置だけでなく、タッチ圧力の大きさを検出できるディスプレイモジュールを含むスマートフォンを提供する。

**【0006】**

本発明の他の実施形態では、ディスプレイモジュールの視認性(visibility)、及び、光透過率を低下させることなしにタッチ位置及びタッチ圧力の大きさを検出することができるように構成された、ディスプレイモジュールを含むスマートフォンを提供する。

30

**【課題を解決するための手段】****【0007】**

本発明の実施形態によるスマートフォンは、カバー層と、前記カバー層の下部に位置し、液晶層及び前記液晶層を挟んで位置する第1ガラス層及び第2ガラス層を含むLCDパネル及び前記LCDパネルがディスプレイ機能を遂行するようにする構成を含むディスプレイモジュールと、前記ディスプレイモジュールの下部に位置する圧力電極と、前記圧力電極の下部に位置する遮蔽用部材と、を含み、静電容量方式でタッチを感知するタッチセンサの少なくとも一部が前記第1ガラス層と前記第2ガラス層との間に位置し、前記タッチセンサは、複数の駆動電極と複数の受信電極とを含み、前記タッチセンサに駆動信号が印加され、前記タッチセンサから出力される感知信号からタッチ位置を検出することができ、前記圧力電極から出力される静電容量の変化量に基づいてタッチ圧力の大きさを検出することができる。

40

**【0008】**

本発明の他の実施形態によるスマートフォンは、カバー層と、前記カバー層の下部に位置し、液晶層及び前記液晶層を挟んで位置する第1ガラス層及び第2ガラス層を含むLCDパネル及び前記LCDパネルがディスプレイ機能を遂行するようにする構成を含むディスプレイモジュールと、前記ディスプレイモジュールの下部に位置する圧力電極と、前記圧力電極の下部に位置する遮蔽用部材と、を含み、静電容量方式でタッチを感知するタッチセンサの少なくとも一部が前記第1ガラス層と前記第2ガラス層との間に位置し、前記タッチセンサは、複数の駆動電極と複数の受信電極とを含み、前記タッチセンサに駆動信

50

号を印加するための駆動部と、前記タッチセンサから感知信号を受信してタッチ位置を検出するための感知部と、前記圧力電極から出力される静電容量の変化量に基づいてタッチ圧力の大きさを検出するための圧力検出部と、をさらに含んでもよい。

#### 【0009】

本発明の他の実施形態によるスマートフォンは、カバー層と、前記カバー層の下部に位置し、液晶層及び前記液晶層を挟んで位置する第1ガラス層及び第2ガラス層を含むLCDパネル及び前記LCDパネルがディスプレイ機能を遂行するようにする構成を含むディスプレイモジュールと、前記ディスプレイモジュールの下部に位置する圧力電極と、前記圧力電極と離隔された基準電位層と、を含み、静電容量方式でタッチを感知するタッチセンサの少なくとも一部が前記第1ガラス層と前記第2ガラス層との間に位置し、前記タッチセンサは、複数の駆動電極と複数の受信電極とを含み、前記タッチセンサに駆動信号が印加され、前記タッチセンサから出力される感知信号からタッチ位置を検出することができ、前記圧力電極から出力される静電容量の変化量に基づいてタッチ圧力の大きさを検出することができ、前記静電容量の変化量は、前記圧力電極と前記基準電位層との間の距離によって変わり得る。10

#### 【発明の効果】

#### 【0010】

本発明の実施形態によれば、タッチスクリーン上のタッチの位置だけでなく、タッチ圧力の大きさを検出できるディスプレイモジュールを含むスマートフォンを提供することができる。20

#### 【0011】

また、本発明の実施形態によれば、ディスプレイモジュールの視認性(visibility)、及び、光透過率を低下させることなしにタッチ位置及びタッチ圧力の大きさを検出することができるよう構成された、ディスプレイモジュールを含むスマートフォンを提供することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【0012】

【図1】本発明の実施形態による静電容量方式のタッチセンサパネル及びこの動作のための構成の概略図である。

【図2a】本発明の実施形態によるタッチ入力装置において、ディスプレイモジュールに対するタッチセンサパネルの相対的な位置を例示する概念図である。30

【図2b】本発明の実施形態によるタッチ入力装置において、ディスプレイモジュールに対するタッチセンサパネルの相対的な位置を例示する概念図である。

【図2c】本発明の実施形態によるタッチ入力装置において、ディスプレイモジュールに対するタッチセンサパネルの相対的な位置を例示する概念図である。

【図3】本発明の第1実施形態によりタッチ位置及びタッチ圧力を検出できるように構成されたタッチ入力装置の断面図である。

【図4】本発明の第2実施形態によるタッチ入力装置の断面図である。

【図5】本発明の第2実施形態によるタッチ入力装置の斜視図である。

【図6a】本発明の第1実施形態による圧力電極パターンを含むタッチ入力装置の断面図である。40

【図6b】図6aに示されたタッチ入力装置に圧力が印加された場合の断面図である。

【図6c】本発明の第2実施形態による圧力電極を含むタッチ入力装置の断面図である。

【図6d】本発明の第1実施形態による圧力電極パターンを例示する。

【図6e】本発明の第2実施形態による圧力電極パターンを例示する。

【図6f】本発明の実施形態に適用され得る圧力電極パターンを例示する。

【図6g】本発明の実施形態に適用され得る圧力電極パターンを例示する。

【図7a】本発明の第3実施形態による圧力電極を含むタッチ入力装置の断面図である。

【図7b】本発明の第3実施形態による圧力電極パターンを例示する。

【図8】本発明の実施形態による圧力電極の付着構造を例示する。50

【図9a】本発明の第2実施形態による圧力電極の付着方法を例示する。

【図9b】本発明の第2実施形態による圧力電極の付着方法を例示する。

【図10a】本発明の第2実施形態による圧力電極をタッチセンシング回路に連結する方法を例示する。

【図10b】本発明の第2実施形態による圧力電極をタッチセンシング回路に連結する方法を例示する。

【図10c】本発明の第2実施形態による圧力電極をタッチセンシング回路に連結する方法を例示する。

【図11a】本発明の実施形態による圧力電極が複数のチャネルを構成する場合を例示する。

10

【図11b】本発明の実施形態による圧力電極が複数のチャネルを構成する場合を例示する。

【図11c】本発明の実施形態による圧力電極が複数のチャネルを構成する場合を例示する。

【図12】本発明の実施形態によるタッチ入力装置1000のタッチ表面中心部を非伝導性客体で加圧する実験を遂行し、客体のグラム重量による静電容量の変化量を表示するグラフである。

#### 【発明を実施するための形態】

##### 【0013】

20

後述する本発明に対する詳細な説明は、本発明を実施することができる特定の実施形態を例示として図示する添付の図面を参照する。これらの実施形態は、当業者が本発明を実施するのに十分なように詳しく説明する。本発明の多様な実施形態は互いに異なるが、相互に排他的である必要はないことが理解されなければならない。例えば、ここに記載されている特定の形状、構造及び特性は、一実施形態に関連して本発明の精神及び範囲を外れないながらも、他の実施形態で具現されてもよい。また、それぞれの開示された実施形態内の個別構成要素の位置又は配置は、本発明の精神及び範囲を外れないながらも、変更されてもよいことが理解されなければならない。したがって、後述する詳細な説明は、限定的な意味として取ろうとするのではなく、本発明の範囲は、適切に説明されるならば、その請求項が主張するのと均等なすべての範囲とともに添付された請求項によってのみ限定される。図面において類似の参照符号は様々な側面にわたって同一もしくは類似の機能を指し示す。

30

##### 【0014】

以下、添付される図面を参照して本発明の実施形態によるタッチ入力装置を説明する。以下では、静電容量方式のタッチセンサパネル100及び圧力検出モジュール400を例示するが、任意の方式でタッチ位置及び/又はタッチ圧力を検出できるタッチセンサパネル100及び圧力検出モジュール400が適用されてもよい。

##### 【0015】

図1は、本発明の実施形態による静電容量方式のタッチセンサパネル100及びこの動作のための構成の概略図である。図1を参照すると、本発明の実施形態によるタッチセンサパネル100は、複数の駆動電極TX1～TXn及び複数の受信電極RX1～RXmを含み、前記タッチセンサパネル100の動作のために複数の駆動電極TX1～TXnに駆動信号を印加する駆動部120、及びタッチセンサパネル100のタッチ表面に対するタッチによって変化する静電容量の変化量に対する情報を含む感知信号を受信して、タッチ及びタッチ位置を検出する感知部100を含んでもよい。

40

##### 【0016】

図1に示されたように、タッチセンサパネル100は、複数の駆動電極TX1～TXnと複数の受信電極RX1～RXmとを含んでもよい。図1においては、タッチセンサパネル100の複数の駆動電極TX1～TXnと複数の受信電極RX1～RXmとが直交アレイを構成しているが、本発明はこれに限定されず、複数の駆動電極TX1～TXnと複数の受信電極RX1～RXmが対角線、同心円、及び3次元ランダム配列な

50

どをはじめとする任意の数の次元、及びこの応用配列を有するようにすることができる。ここで、n 及びmは、量の整数として互いに同じか、もしくは異なる値を有してもよく、実施形態により大きさが変わってもよい。

#### 【0017】

図1に示されたように、複数の駆動電極TX1～TXnと複数の受信電極RX1～RXmとは、それぞれ互いに交差するように配列されてもよい。駆動電極TXは、第1軸方向に伸びた複数の駆動電極TX1～TXnを含み、受信電極RXは、第1軸方向と交差する第2軸方向に伸びた複数の受信電極RX1～RXmを含んでもよい。

#### 【0018】

本発明の実施形態によるタッチセンサパネル100において、複数の駆動電極TX1～TXnと複数の受信電極RX1～RXmとは、互いに同一の層に形成されてもよい。例えば、複数の駆動電極TX1～TXnと複数の受信電極RX1～RXmとは、絶縁膜(図示せず)の同一の面に形成されてもよい。また、複数の駆動電極TX1～TXnと複数の受信電極RX1～RXmは、互いに異なる層に形成されてもよい。例えば、複数の駆動電極TX1～TXnと複数の受信電極RX1～RXmは、一つの絶縁膜(図示せず)の両面にそれぞれ形成されてもよく、又は、複数の駆動電極TX1～TXnは、第1絶縁膜(図示せず)の一面に、そして複数の受信電極RX1～RXmは、前記第1絶縁膜と異なる第2絶縁膜(図示せず)の一面上に形成されてもよい。

#### 【0019】

複数の駆動電極TX1～TXnと複数の受信電極RX1～RXmとは、透明伝導性物質(例えば、酸化スズ(SnO<sub>2</sub>)及び酸化インジウム(Indium Tin Oxide)等からなるITO(Indium Tin Oxide)又はATO(Antimony Tin Oxide))等から形成されてもよい。しかし、これは単に例示に過ぎず、駆動電極TX及び受信電極RXは、他の透明伝導性物質又は不透明伝導性物質から形成されてもよい。例えば、駆動電極TX及び受信電極RXは、銀インク(silver ink)、銅(copper)又は炭素ナノチューブ(CNT:Carbon Nanotube)のうち少なくとも何れか一つを含んで構成されてもよい。また、駆動電極TX及び受信電極RXは、メタルメッシュ(metal mesh)で具現されるか、もしくは銀ナノ(nano silver)物質から構成されてもよい。

#### 【0020】

本発明の実施形態による駆動部120は、駆動信号を駆動電極TX1～TXnに印加することができる。本発明の実施形態において、駆動信号は、第1駆動電極TX1から第n駆動電極TXnまで順次一度に一つの駆動電極に対して印加されてもよい。このような駆動信号の印加は、再度反復して成されてもよい。これは単に例示に過ぎず、実施形態により多数の駆動電極に駆動信号が同時に印加されてもよい。

#### 【0021】

感知部110は、受信電極RX1～RXmを通じて駆動信号が印加された駆動電極TX1～TXnと受信電極RX1～RXmとの間に生成された静電容量CM:101に関する情報を含む感知信号を受信することによって、タッチの有無及びタッチ位置を検出することができる。例えば、感知信号は、駆動電極TXに印加された駆動信号が駆動電極TXと受信電極RXとの間に生成された静電容量CM:101によりカップリングされた信号であってもよい。このように、第1駆動電極TX1から第n駆動電極TXnまで印加された駆動信号を受信電極RX1～RXmを通じて感知する過程は、タッチセンサパネル100をスキャン(scan)すると指称すことができる。

#### 【0022】

例えば、感知部110は、それぞれの受信電極RX1～RXmとスイッチを通じて連結された受信機(図示せず)を含んで構成されてもよい。前記スイッチは、該当受信電極RXの信号を感知する時間区間に、オン(on)になって受信電極RXから感知信号が受信機で感知され得るようにする。受信機は、増幅器(図示せず)及び増幅器の負(-)入力端と増幅器の出力端との間、すなわち帰還経路に結合した帰還キャパシタを含んで構成さ

10

20

30

40

50

れてもよい。この時、増幅器の正(+)入力端は、グランド(g r o u n d)に接続されてもよい。また、受信機は、帰還キャパシタと並列に連結されるリセットスイッチをさらに含んでもよい。リセットスイッチは、受信機によって遂行される電流において電圧への変換をリセットすることができる。増幅器の負入力端は、該当受信電極R Xと連結されて静電容量C M : 1 0 1に対する情報を含む電流信号を受信した後、積分して電圧に変換することができる。感知部1 1 0は、受信機を通じて積分されたデータをデジタルデータに変換するA D C (図示せず: a n a l o g t o d i g i t a l c o n v e r t e r)をさらに含んでもよい。その後、デジタルデータはプロセッサ(図示せず)に入力され、タッチセンサパネル1 0 0に対するタッチ情報を取得するように処理されてもよい。感知部1 1 0は受信機とともに、A D C及びプロセッサを含んで構成されてもよい。

10

#### 【0 0 2 3】

制御部1 3 0は、駆動部1 2 0と感知部1 1 0の動作を制御する機能を遂行することができる。例えば、制御部1 3 0は、駆動制御信号を生成した後、駆動部1 2 0に伝達して駆動信号が所定の時間にあらかじめ設定された駆動電極T Xに印加されるようにすることができる。また、制御部1 3 0は、感知制御信号を生成した後、感知部1 1 0に伝達して感知部1 1 0が所定の時間にあらかじめ設定された受信電極R Xから感知信号の入力を受けて、あらかじめ設定された機能を遂行するようにすることができる。

#### 【0 0 2 4】

図1において駆動部1 2 0及び感知部1 1 0は、本発明の実施形態によるタッチセンサパネル1 0 0に対するタッチの有無及びタッチ位置を検出することができるタッチ検出装置(図示せず)を構成することができる。本発明の実施形態によるタッチ検出装置は、制御部1 3 0をさらに含んでもよい。本発明の実施形態によるタッチ検出装置は、タッチセンサパネル1 0 0を含むタッチ入力装置1 0 0 0において、タッチセンシング回路であるタッチセンシングI C (t o u c h s e n s i n g I n t e g r a t e d C i r c u i t: 図1 0の1 5 0)上に集積されて具現されてもよい。タッチセンサパネル1 0 0に含まれた駆動電極T X及び受信電極R Xは、例えば伝導性トレース(c o n d u c t i v e t r a c e)及び/又は回路基板上に印刷された伝導性パターン(c o n d u c t i v e p a t t e r n)等を通じてタッチセンシングI C 1 5 0に含まれた駆動部1 2 0及び感知部1 1 0に連結されてもよい。タッチセンシングI C 1 5 0は、伝導性パターンが印刷された回路基板、例えば図1 0において1 6 0で表示される第1印刷回路基板(以下で、第1P C Bという)上に位置することができる。実施形態によりタッチセンシングI C 1 5 0は、タッチ入力装置1 0 0 0の作動のためのメインボード上に実装されていてもよい。

20

#### 【0 0 2 5】

以上で詳しく見たように、駆動電極T Xと受信電極R Xの交差地点ごとに所定値の静電容量Cが生成され、指のような客体がタッチセンサパネル1 0 0に近接する場合、このような静電容量の値が変更されてもよい。図1において、前記静電容量は、相互静電容量C mを表わしてもよい。このような電気的特性を感知部1 1 0で感知し、タッチセンサパネル1 0 0に対するタッチの有無及び/又はタッチ位置を感知することができる。例えば、第1軸と第2軸とからなる2次元平面からなるタッチセンサパネル1 0 0の表面に対するタッチの有無及び/又はその位置を感知することができる。

30

#### 【0 0 2 6】

より具体的に、タッチセンサパネル1 0 0に対するタッチが生じる時、駆動信号が印加された駆動電極T Xを検出することによって、タッチの第2軸方向の位置を検出することができる。これと同様に、タッチセンサパネル1 0 0に対するタッチの際に受信電極R Xを通じて受信された受信信号から静電容量の変化を検出することによって、タッチの第1軸方向の位置を検出することができる。

40

#### 【0 0 2 7】

以上で、タッチセンサパネル1 0 0として相互静電容量方式のタッチセンサパネルが詳しく説明されたが、本発明の実施形態によるタッチ入力装置1 0 0 0において、タッチの

50

有無及びタッチ位置を検出するためのタッチセンサパネル100は、前述した方法以外の自己静電容量方式、表面静電容量方式、プロジェクテッド(projected)静電容量方式、抵抗膜方式、表面弾性波方式(SAW:surface acoustic wave)、赤外線(infrared)方式、光学的イメージング方式(optical imaging)、分散信号方式(dispersive signal technology)、及び音声パルス認識(acoustic pulse recognition)方式など、任意のタッチセンシング方式を用いて具現されてもよい。

#### 【0028】

本発明の実施形態によるタッチ入力装置1000においてタッチ位置を検出するためのタッチセンサパネル100は、ディスプレイモジュール200の外部又は内部に位置してもよい。10

#### 【0029】

本発明の実施形態によるタッチ入力装置1000のディスプレイモジュール200は、液晶表示装置(LCD:Liquid Crystal Display)、PDP(Plasma Display Panel)、有機発光表示装置(Organic Light Emitting Diode:OLED)などに含まれたディスプレイパネルであってもよい。これにより、使用者はディスプレイパネルに表示された画面を視覚的に確認しながら、タッチ表面にタッチを遂行して入力行為を行うことができる。この時、ディスプレイモジュール200は、タッチ入力装置1000の作動のためのメインボード(main board)上の中央処理ユニットであるCPU(central processing unit)又はAP(application processor)などから入力を受けて、ディスプレイパネルに所望する内容をディスプレイするようにする制御回路を含んでもよい。このような制御回路は、図8aないし9cにおいて第2印刷回路基板210(以下、第2PCBという)に実装されてもよい。この時、ディスプレイパネル200の作動のための制御回路は、ディスプレイパネル制御IC、グラフィック制御IC(graphic controller IC)、及びその他のディスプレイパネル200の作動に必要な回路を含んでもよい。20

#### 【0030】

図2a、図2b及び図2cは、本発明の実施形態によるタッチ入力装置において、ディスプレイモジュールに対するタッチセンサパネルの相対的な位置を例示する概念図である。30 図2aないし図2cにおいては、ディスプレイパネルとしてLCDパネルが示されているが、これは例示に過ぎず、任意のディスプレイパネルが本発明の実施形態によるタッチ入力装置1000に適用されてもよい。

#### 【0031】

本願明細書において、図面符号200はディスプレイモジュールを指し示すが、図2及びこれに対する説明において、図面符号200は、ディスプレイモジュールだけでなくディスプレイパネルを指し示してもよい。図2に示されたように、LCDパネルは、液晶セル(liquid crystal cell)を含む液晶層250、液晶層250の両端に電極を含む第1ガラス層261と第2ガラス層262、そして前記液晶層250と対向する方向として前記第1ガラス層261の一面に第1偏光層271及び前記第2ガラス層262の一面に第2偏光層272を含んでもよい。該当技術分野の当業者には、LCDパネルがディスプレイ機能を遂行するために他の構成をさらに含んでもよく、変形が可能なことは自明であろう。40

#### 【0032】

図2aは、タッチ入力装置1000において、タッチセンサパネル100がディスプレイモジュール200の外部に配置されたことを示す。タッチ入力装置1000に対するタッチ表面は、タッチセンサパネル100の表面であってもよい。図2aにおいて、タッチ表面になり得るタッチセンサパネル100の面は、タッチセンサパネル100の上部面になつてもよい。また、実施形態によりタッチ入力装置1000に対するタッチ表面は、ディスプレイモジュール200の外面になつてもよい。図2aにおいて、タッチ表面になり50

得るディスプレイモジュール 200 の外面は、ディスプレイモジュール 200 の第 2 偏光層 272 の下部面になっててもよい。この時、ディスプレイモジュール 200 を保護するために、ディスプレイモジュール 200 の下部面はガラスのようなカバー層（図示せず）で覆われていてもよい。

#### 【0033】

図 2 b 及び 2 c は、タッチ入力装置 1000において、タッチセンサパネル 100 がディスプレイパネル 200 の内部に配置されたことを示す。この時、図 2 b においては、タッチ位置を検出するためのタッチセンサパネル 100 が、第 1 ガラス層 261 と第 1 偏光層 271 との間に配置されている。この時、タッチ入力装置 1000 に対するタッチ表面は、ディスプレイモジュール 200 の外面として図 2 b で上部面又は下部面になってもよい。10 図 2 c においては、タッチ位置を検出するためのタッチセンサパネル 100 が、液晶層 250 に含まれて具現される場合を例示する。この時、タッチ入力装置 1000 に対するタッチ表面は、ディスプレイモジュール 200 の外面として図 2 c で上部面又は下部面になつてもよい。図 2 b 及び図 2 c において、タッチ表面になり得るディスプレイモジュール 200 の上部面又は下部面は、ガラスのようなカバー層（図示せず）で覆われていてもよい。

#### 【0034】

以上においては、本発明の実施形態によるタッチセンサパネル 100 に対するタッチの有無及び／又はタッチの位置を検出することを説明したが、本発明の実施形態によるタッチセンサパネル 100 を用いてタッチの有無及び／又は位置と共にタッチの圧力の大きさを検出することができる。また、タッチセンサパネル 100 と別個にタッチ圧力を検出する圧力検出モジュールをさらに含んで、タッチの圧力の大きさを検出することも可能である。20

#### 【0035】

図 3 は、本発明の第 1 実施形態により、タッチ位置及びタッチ圧力を検出できるように構成されたタッチ入力装置の断面図である。

#### 【0036】

ディスプレイモジュール 200 を含むタッチ入力装置 1000 において、タッチ位置を検出するためのタッチセンサパネル 100 及び圧力検出モジュール 400 は、ディスプレイモジュール 200 の前面に付着されてもよい。これにより、ディスプレイモジュール 200 のディスプレイスクリーンを保護して、タッチセンサパネル 100 のタッチ検出の感度を高めることができる。30

#### 【0037】

この時、圧力検出モジュール 400 は、タッチ位置を検出するためのタッチセンサパネル 100 と別個に動作することができるので、例えば、圧力検出モジュール 400 は、タッチ位置を検出するためのタッチセンサパネル 100 と独立して圧力だけを検出するように構成されてもよい。また、圧力検出モジュール 400 は、タッチ位置を検出するためのタッチセンサパネル 100 と結合してタッチ圧力を検出するように構成されてもよい。例えば、タッチ位置を検出するためのタッチセンサパネル 100 に含まれた駆動電極 TX と受信電極 RX のうち少なくとも一つの電極は、タッチ圧力を検出するのに用いられてもよい。40

#### 【0038】

図 3 において、圧力検出モジュール 400 は、タッチセンサパネル 100 と結合してタッチ圧力を検出できる場合を例示する。図 3 において、圧力検出モジュール 400 は、前記タッチセンサパネル 100 とディスプレイモジュール 200 との間を離隔させるスペーサ層 420 を含む。圧力検出モジュール 400 は、スペーサ層 420 を通じてタッチセンサパネル 100 と離隔した基準電位層を含んでもよい。この時、ディスプレイモジュール 200 は、基準電位層として機能することができる。

#### 【0039】

基準電位層は、駆動電極 TX と受信電極 RX との間に生成された静電容量 101 に変化50

を引き起こさせるようにする任意の電位を有してもよい。例えば、基準電位層は、グランド (ground) 電位を有するグランド層であってもよい。基準電位層は、ディスプレイモジュール 200 のグランド (ground) 層であってもよい。この時、基準電位層は、タッチセンサパネル 100 の 2 次元平面と平行した平面を有してもよい。

#### 【0040】

図 3 に示されたように、タッチセンサパネル 100 と基準電位層であるディスプレイモジュール 200 とは、離隔して位置する。この時、タッチセンサパネル 100 とディスプレイモジュール 200 の接着方法の差によって、タッチセンサパネル 100 とディスプレイモジュール 200 との間のスペーサ層 420 は、エアギャップ (air gap) で具現されてもよい。

10

#### 【0041】

この時、タッチセンサパネル 100 とディスプレイモジュール 200 を固定するために、両面接着テープ 430 (DAT: Double Adhesive Tape) が用いられてもよい。例えば、タッチセンサパネル 100 とディスプレイモジュール 200 は、それぞれの面積が重ねられた形態であり、タッチセンサパネル 100 とディスプレイモジュール 200 それぞれの端領域において両面接着テープ 430 を介して二つの層が接着されるが、残りの領域においてタッチセンサパネル 100 とディスプレイモジュール 200 とが所定の距離 d に離隔されてもよい。

#### 【0042】

一般的に、タッチセンサパネル 100 の撓みなしにタッチ表面をタッチする場合でも、駆動電極 TX と受信電極 RX との間の静電容量 101 : Cm が変化する。すなわち、タッチセンサパネル 100 に対するタッチの際に、相互静電容量 Cm : 101 が基本相互静電容量に比べて減少する。これは指のような導体である客体がタッチセンサパネル 100 に近接した場合、客体がグランド GND の役割をして相互静電容量 Cm : 101 のフリング静電容量 (fringing capacitance) が客体に吸収されるためである。基本相互静電容量は、タッチセンサパネル 100 に対するタッチがない場合に、駆動電極 TX と受信電極 RX との間の相互静電容量の値である。

20

#### 【0043】

タッチセンサパネル 100 のタッチ表面である上部表面を客体でタッチする際に圧力が加えられた場合、タッチセンサパネル 100 が撓む。この時、駆動電極 TX と受信電極 RX との間の相互静電容量 101 : Cm の値はさらに減少する。これは、タッチセンサパネル 100 が撓んでタッチセンサパネル 100 と基準電位層との間の距離が d から d' に減少することによって、前記相互静電容量 101 : Cm のフリング静電容量が客体だけでなく基準電位層にも吸収されるためである。タッチの客体が不導体である場合には、相互静電容量 Cm の変化は、単にタッチセンサパネル 100 と基準電位層との間の距離変化 d - d' のみに起因してもよい。

30

#### 【0044】

以上で詳しく見たように、ディスプレイモジュール 200 上にタッチセンサパネル 100 及び圧力検出モジュール 400 を含んでタッチ入力装置 1000 を構成することによって、タッチ位置だけでなくタッチ圧力を同時に検出することができる。

40

#### 【0045】

しかし、図 3 に示されたように、タッチセンサパネル 100 だけでなく圧力検出モジュール 400 までディスプレイモジュール 200 の上部に配置させる場合、ディスプレイモジュールのディスプレイ特性が低下する問題点が発生する。特に、ディスプレイモジュール 200 の上部にエアギャップ 420 を含む場合に、ディスプレイモジュールの視認性及び光透過率が低下することがある。

#### 【0046】

したがって、このような問題点が発生することを防止するために、タッチ位置を検出するためのタッチセンサパネル 100 とディスプレイモジュール 200 との間にエアギャップを配置せずに、OCA (Optically Clear Adhesive) のような

50

接着剤でタッチセンサパネル 100 とディスプレイモジュール 200 とが完全ラミネーション ( lamination ) されてもよい。

#### 【 0047 】

図 4 は、本発明の第 2 実施形態によるタッチ入力装置の断面図である。本発明の第 2 実施形態によるタッチ入力装置 1000 において、タッチ位置を検出するためのタッチセンサパネル 100 とディスプレイモジュール 200 との間が接着剤で完全ラミネーションされる。これによりタッチセンサパネル 100 のタッチ表面を通じて確認できるディスプレイモジュール 200 のディスプレイの色の鮮明度、視認性、及び光透過性が向上してもよい。

#### 【 0048 】

図 4 及び図 5、そしてこれを参照した説明において、本発明の第 2 実施形態によるタッチ入力装置 1000 として、タッチセンサパネル 100 がディスプレイモジュール 200 上に接着剤でラミネーションされて付着したものを見示すが、本発明の第 2 実施形態によるタッチ入力装置 1000 は、タッチセンサパネル 100 が図 2 b 及び図 2 c などに示されたように、ディスプレイモジュール 200 の内部に配置される場合も含んでいてよい。より具体的に、図 4 及び図 5 において、タッチセンサパネル 100 がディスプレイモジュール 200 を覆うことが示されているが、タッチセンサパネル 100 はディスプレイモジュール 200 の内部に位置して、ディスプレイモジュール 200 がガラスのようなカバー層で覆われたタッチ入力装置 1000 が、本発明の第 2 実施形態に用いられてよい。

#### 【 0049 】

本発明の実施形態によるタッチ入力装置 1000 は、携帯電話 ( cell phone )、PDA ( Personal Data Assistant )、スマートフォン ( smart phone )、タブレット PC ( tablet Personal Computer )、MP3 プレーヤー、ノートブック ( notebook ) などのようなタッチスクリーンを含む電子装置を含んでもよい。

#### 【 0050 】

本発明の実施形態によるタッチ入力装置 1000 において、基板 300 は、例えばタッチ入力装置 1000 の最外郭をなす機構であるカバー 320 と共にタッチ入力装置 1000 の作動のための回路基板及び / 又はバッテリーが位置することができる実装空間 310 などを覆うハウジング ( housing ) の機能を遂行することができる。この時、タッチ入力装置 1000 の作動のための回路基板には、メインボード ( main board ) として中央処理ユニットである CPU ( central processing unit ) 又は APU ( application processor ) などが実装されていてよい。基板 300 を通じてディスプレイモジュール 200 とタッチ入力装置 1000 の作動のための回路基板及び / 又はバッテリーが分離し、ディスプレイモジュール 200 で発生する電気的ノイズが遮断されてもよい。

#### 【 0051 】

タッチ入力装置 1000 において、タッチセンサパネル 100 又は前面カバー層が、ディスプレイモジュール 200 、基板 300 、及び実装空間 310 より広く形成されてもよく、これによりカバー 320 がタッチセンサパネル 100 と共にディスプレイモジュール 200 、基板 300 及び回路基板 310 を覆うように、カバー 320 が形成されてもよい。

#### 【 0052 】

本発明の第 2 実施形態によるタッチ入力装置 1000 は、タッチセンサパネル 100 を通じてタッチ位置を検出し、ディスプレイモジュール 200 と基板 300 との間に圧力検出モジュール 400 を配置してタッチ圧力を検出することができる。この時、タッチセンサパネル 100 は、ディスプレイモジュール 200 の内部又は外部に位置することができる。圧力検出モジュール 400 は、例えば、エアギャップ ( air gap ) からなったスペーサ層 420 を含んで構成され、これに対しては図 5 ないし図 7 b を参照して詳しく

見てみる。スペーサ層420は、実施形態により衝撃吸収物質からなってもよい。スペーサ層420は、実施形態により誘電物質(dielectric material)で満たされてもよい。

#### 【0053】

図5は、本発明の第2実施形態によるタッチ入力装置の斜視図である。図5に示されたように、本発明の実施形態によるタッチ入力装置1000において、圧力検出モジュール400は、ディスプレイモジュール200と基板300を離隔させるスペーサ層420、及びスペーサ層420内に位置する電極450及び460を含んでもよい。以下で、タッチセンサパネル100に含まれた電極と区分が明確なように、圧力を検出するための電極450及び460を圧力電極450及び460と指称する。この時、圧力電極450及び460は、ディスプレイパネルの前面でない後面に含まれるので、透明物質だけでなく不透明物質で構成されることも可能である。10

#### 【0054】

この時、スペーサ層420を維持するために、基板300の上部の縁に沿って所定の厚さを有する接着テープ440が形成されてもよい。図5において、接着テープ440は基板300のすべての縁(例えば、四角形の4辺)に形成されたものが図示されているが、接着テープ440は基板の縁のうち少なくとも一部(例えば、四角形の3辺)にのみ形成されてもよい。実施形態により、接着テープ440は、基板300の上部面又はディスプレイモジュール200の下部面に形成されてもよい。接着テープ440は、基板300とディスプレイモジュール200を同一の電位に作るために伝導性テープであってもよい。また、接着テープ440は、両面接着テープであってもよい。本発明の実施形態において、接着テープ440は、弾性のない物質で構成されてもよい。本発明の実施形態において、ディスプレイモジュール200に圧力が印加される場合、ディスプレイモジュール200が撓み得るので、接着テープ440が圧力によって形体の変形がなくても、タッチ圧力の大きさを検出することができる。20

#### 【0055】

図6aは、本発明の第1実施形態による圧力電極パターンを含むタッチ入力装置の断面図である。図6aに示されたように、本発明の第1実施形態による圧力電極450、460は、スペーサ層420内として基板300上に形成されてもよい。

#### 【0056】

圧力検出のための圧力電極は、第1電極450と第2電極460とを含んでもよい。この時、第1電極450と第2電極460のうち、いずれか一つは駆動電極であってもよく、残りの一つは受信電極であってもよい。駆動電極に駆動信号を印加して受信電極を通じて感知信号を獲得することができる。電圧が印加されると、第1電極450と第2電極460との間に相互静電容量が生成されてもよい。30

#### 【0057】

図6bは、図6aに示されたタッチ入力装置1000に圧力が印加された場合の断面図である。ディスプレイモジュール200の下部面は、ノイズ遮蔽のためにグランド(ground)電位を有してもよい。客体500を通じてタッチセンサパネル100の表面に圧力を印加する場合、タッチセンサパネル100及びディスプレイモジュール200は撓み得る。これによりグランド電位面と圧力電極パターン450、460との間の距離dがd'に減少する。このような場合、前記距離dの減少によりディスプレイモジュール200の下部面にフリンジング静電容量が吸収されるので、第1電極450と第2電極460との間の相互静電容量は減少する。したがって、受信電極を通じて取得される感知信号において、相互静電容量の減少量を取得してタッチ圧力の大きさを算出することができる。40

#### 【0058】

本発明の実施形態によるタッチ入力装置1000において、ディスプレイモジュール200は、圧力を印加するタッチによって撓み得る。ディスプレイモジュール200は、タッチの位置で最も大きい変形を示すように撓み得る。実施形態によりディスプレイモジュール200が撓むとき、最も大きい変形を示す位置は、前記タッチ位置と一致しないこと50

もあるが、ディスプレイモジュール 200 は、少なくとも前記タッチ位置で撓みを示すことができる。例えば、タッチ位置がディスプレイモジュール 200 の縁や端などに近接する場合、ディスプレイモジュール 200 が撓む程度が最も大きい位置はタッチ位置と異なることがあるが、ディスプレイモジュール 200 は、少なくとも前記タッチ位置で撓みを示すことができる。

#### 【0059】

この時、基板 300 の上部面もまたノイズ遮蔽のためにグランド電位を有してもよい。したがって、基板 300 と圧力電極 450、460 が短絡 (short circuit) することを防止するために、圧力電極 450、460 は絶縁層 470 上に形成されてもよい。図 8 は、本発明の実施形態による圧力電極の付着構造を例示する。図 8 (a) を参考して説明すると、圧力電極 450、460 は、基板 300 上に第 1 絶縁層 470 を位置させた後、圧力電極 450、460 を形成して構成されてもよい。また、実施形態により圧力電極 450、460 が形成された第 1 絶縁層 470 を基板 300 上に付着して形成することができる。また、実施形態により圧力電極は、基板 300 又は基板 300 上の第 1 絶縁層 470 上に圧力電極パターンに相応する貫通孔を有するマスク (mask) を位置させた後、伝導性スプレー (spray) を噴射することによって形成されてもよい。

10

#### 【0060】

また、ディスプレイモジュール 200 の下部面がグランド電位を有する場合、基板 300 上に位置した圧力電極 450、460 とディスプレイモジュール 300 とが短絡するのを防止するために、圧力電極 450、460 は追加の第 2 絶縁層 471 で圧力電極 450、460 を覆うことができる。また、第 1 絶縁層 470 上に形成された圧力電極 450、460 を追加の第 2 絶縁層 471 で覆った後、一体型で基板 300 上に付着して圧力検出モジュール 400 を形成することができる。

20

#### 【0061】

図 8 (a) を参考して説明された圧力電極 450、460 の付着構造及び方法は、圧力電極 450、460 がディスプレイモジュール 200 に付着する場合にも適用されてもよい。圧力電極 450、460 がディスプレイモジュール 200 に付着する場合は、図 6c と関連してさらに詳しく説明される。

#### 【0062】

また、タッチ入力装置 1000 の種類及び / 又は具現方式により、圧力電極 450、460 が付着する基板 300 又はディスプレイモジュール 200 がグランド電位を示さないか、もしくは弱いグランド電位を示してもよい。このような場合、本発明の実施形態によるタッチ入力装置 1000 は、基板 300 又はディスプレイモジュール 200 と絶縁層 470 との間にグランド電極 (ground electrode : 図示せず) をさらに含んでもよい。実施形態により、グランド電極と基板 300 又はディスプレイモジュール 200 との間には、また別の絶縁層 (図示せず) をさらに含んでもよい。この時、グランド電極 (図示せず) は、圧力電極である第 1 電極 450 と第 2 電極 460 との間に生成される静電容量の大きさが非常に大きくなるのを防止することができる。

30

#### 【0063】

以上で説明した圧力電極 450、460 の形成及び付着方法は、以下の実施形態にも同様に適用されてもよい。

40

#### 【0064】

図 6c は、本発明の第 2 実施形態による圧力電極を含むタッチ入力装置の断面図である。第 1 実施形態において、圧力電極 450、460 が基板 300 上に形成されたことが例示されているが、圧力電極 450、460 は、ディスプレイモジュール 200 の下部面上に形成されても構わない。この時、基板 300 はグランド電位を有してもよい。したがって、タッチセンサパネル 100 のタッチ表面をタッチすることにより、基板 300 と圧力電極 450、460 との間の距離 d が減少して、結果的に第 1 電極 450 と第 2 電極 460 との間の相互静電容量の変化を引き起こすことができる。

#### 【0065】

50

図 6 d は、本発明の第 1 実施形態による圧力電極パターンを例示する。図 6 d では、第 1 電極 450 と第 2 電極 460 とが基板 300 上に形成された場合を示す。第 1 電極 450 と第 2 電極 460 との間の静電容量は、ディスプレイモジュール 200 の下部面と圧力電極 450、460 との間の距離によって変わり得る。

#### 【 0 0 6 6 】

図 6 e は、本発明の第 2 実施形態による圧力電極パターンを例示する。図 6 e において、圧力電極 450、460 は、ディスプレイモジュール 200 の下部面上に形成された場合を示す。

#### 【 0 0 6 7 】

図 6 f 及び図 6 g は、本発明の実施形態に適用され得る圧力電極パターン 450、460 を例示する。第 1 電極 450 と第 2 電極 460 との間の相互静電容量が変化することによってタッチ圧力の大きさを検出する時、検出の正確度を高めるために必要な静電容量の範囲を生成するように、第 1 電極 450 と第 2 電極 460 のパターンを形成する必要がある。第 1 電極 450 と第 2 電極 460 とが互いに向かい合う面積が大きいか、もしくは長さが長いほど、生成される静電容量の大きさが大きくなってもよい。したがって、必要な静電容量の範囲により、第 1 電極 450 と第 2 電極 460 との間の向かい合う面積の大きさ、長さ及び形状などを調節して設計することができる。図 6 f 及び図 6 g には、第 1 電極 450 と第 2 電極 460 とが同一の層に形成される場合として、第 1 電極 450 と第 2 電極 460 とが互いに向かい合う長さが相対的に長いように圧力電極が形成された場合を例示する。

#### 【 0 0 6 8 】

第 1 実施形態と第 2 実施形態において、第 1 電極 450 と第 2 電極 460 は、同一の層に形成されたもので示されているが、第 1 電極 450 と第 2 電極 460 は、実施形態により互いに異なる層に具現されても構わない。図 8 ( b ) は、第 1 電極 450 と第 2 電極 460 とが互いに異なる層に具現された場合の付着構造を例示する。図 8 ( b ) に例示されたように、第 1 電極 450 は第 1 絶縁層 470 上に形成され、第 2 電極 460 は第 1 電極 450 上に位置する第 2 絶縁層 471 上に形成されてもよい。実施形態により、第 2 電極 460 は第 3 絶縁層 472 で覆われてもよい。この時、第 1 電極 450 と第 2 電極 460 とは互いに異なる層に位置するので、互いにオーバーラップ ( overlap ) するように具現されてもよい。例えば、第 1 電極 450 と第 2 電極 460 とは、図 1 を参照して説明されたタッチセンサパネル 100 に含まれた M × N の構造で配列された駆動電極 TX と受信電極 RX のパターンと類似するように形成されてもよい。この時、M 及び N は、1 以上の自然数であってもよい。

#### 【 0 0 6 9 】

第 1 実施形態において、タッチ圧力は、第 1 電極 450 と第 2 電極 460 との間の相互静電容量の変化から検出されることが例示される。しかし、圧力電極 450、460 が第 1 電極 450 と第 2 電極 460 の何れか一つの圧力電極のみを含むように構成されてもよく、このような場合、一つの圧力電極とグランド層（ディスプレイモジュール 200 又は基板 300）との間の静電容量の変化を検出することによって、タッチ圧力の大きさを検出することもできる。

#### 【 0 0 7 0 】

例えば、図 6 a において、圧力電極は第 1 電極 450 のみを含んで構成されてもよく、この時、ディスプレイモジュール 200 と第 1 電極 450 との間の距離変化によって引き起こされる第 1 電極 450 とディスプレイモジュール 200 との間の静電容量の変化からタッチ圧力の大きさを検出することができる。タッチ圧力が大きくなることによって距離 d が減少するので、ディスプレイモジュール 200 と第 1 電極 450 との間の静電容量は、タッチ圧力が増加するほど大きくなり得る。これは、図 6 c と関連した実施形態にも同様に適用されてもよい。この時、圧力電極は、相互静電容量の変化量の検出精度を高めるために必要な、くし形状又はフォーク形状を有する必要はなく、図 7 b に例示されたように、板（例えば、四角板）形状を有してもよい。

10

20

30

40

50

## 【0071】

図8(c)は、圧力電極が第1電極450のみを含んで具現された場合の付着構造を例示する。図8(c)に例示されたように、第1電極450は、基板300又はディスプレイモジュール200上に位置した第1絶縁層470上に形成されてもよい。また、実施形態により第1電極450は第2絶縁層471で覆われてもよい。

## 【0072】

図7aは、本発明の第3実施形態による圧力電極を含むタッチ入力装置の断面図である。本発明の第3実施形態による圧力電極450、460は、スペーサ層420内として基板300の上部面及びディスプレイモジュール200の下部面上に形成されてもよい。  
10

## 【0073】

圧力検出のための圧力電極パターンは、第1電極450と第2電極460を含んでもよい。この時、第1電極450と第2電極460の何れか一つは基板300上に形成され、残りの一つはディスプレイモジュール200の下部面上に形成されてもよい。図7aにおいては、第1電極450が基板300上に形成され、第2電極460がディスプレイモジュール200の下部面上に形成されたことを例示する。

## 【0074】

客体500を通じてタッチセンサパネル100の表面に圧力を印加する場合、タッチセンサパネル100及びディスプレイモジュール200は撓み得る。これにより第1電極450及び第2電極460との間の距離dが減少する。このような場合、前記距離dの減少により、第1電極450と第2電極460との間の相互静電容量は増加する。したがって、受信電極を通じて取得される感知信号において、相互静電容量の減少量を取得してタッチ圧力の大きさを算出することができる。  
20

## 【0075】

図7bは、本発明の第3実施形態による圧力電極パターンを例示する。図7bでは、第1電極450が基板300の上部面上に形成され、第2電極460がディスプレイモジュール200の下部面上に形成されたことが示される。図7bに示されたように、第1電極450と第2電極460とが互いに異なる層に形成されるので、第1実施形態と第2実施形態とは異なり、第1電極450及び第2電極460は、くし形状又はフォーク形状を有する必要はなく、板形状(例えば、四角板形状)を有してもよい。  
30

## 【0076】

図8(d)は、第1電極450が基板300上に付着し、第2電極460がディスプレイモジュール200に付着した場合の付着構造を例示する。図8(d)に例示されたように、第1電極450は、基板300上に形成された第1絶縁層470-2上に位置し、第1電極450は第2絶縁層471-2によって覆われていてもよい。また、第2電極460はディスプレイモジュール200の下部面上に形成された第1絶縁層470-1上に位置し、第2電極460は第2絶縁層471-1によって覆われていてもよい。

## 【0077】

図8(a)と関連して説明されたことと同様に、圧力電極450、460が付着する基板300又はディスプレイモジュール200がグランド電位を示さないか、もしくは弱いグランド電位を示す場合、図8(a)ないし図8(d)において第1絶縁層470、470-1、470-2の間にグランド電極(図示せず)をさらに含んでもよい。この時、グランド電極(図示せず)と圧力電極450、460が付着する基板300又はディスプレイモジュール200の間には、追加の絶縁層(図示せず)をさらに含んでもよい。  
40

## 【0078】

以上で詳しく見たように、本発明の実施形態によるタッチ入力装置1000は、圧力電極450、460で発生する静電容量の変化を感知する。したがって、第1電極450と第2電極460のうち駆動電極には駆動信号が印加される必要があり、受信電極から感知信号を取得して静電容量の変化量からタッチ圧力を算出しなければならない。実施形態により、圧力検出モジュール400の動作のためのタッチセンシングICを追加で含む  
50

ことも可能である。このような場合、図1に示されたように、駆動部120、感知部110、及び制御部130と類似した構成を重複して含むようになるので、タッチ入力装置1000の面積及び体積が大きくなる問題点が発生し得る。

#### 【0079】

実施形態により、圧力検出モジュール400は、タッチセンサパネル100の作動のためのタッチ検出装置を通じて駆動信号が印加され、感知信号の入力を受けてタッチ圧力を検出することができる。以下では、第1電極450が駆動電極であり、第2電極460が受信電極である場合を仮定して説明する。

#### 【0080】

このために、本発明の実施形態によるタッチ入力装置1000において、第1電極450は駆動部120から駆動信号の印加を受け、第2電極460は感知信号を感知部110に伝達することができる。制御部130は、タッチセンサパネル100のスキャニングを遂行すると共に圧力検出モジュール400のスキャニングを遂行するようにしたり、又は、制御部130は時分割して第1時間区間にはタッチセンサパネル100のスキャニングを遂行するようにし、第1時間区間とは異なる第2時間区間には圧力検出モジュール400のスキャニングを遂行するように制御信号を生成することができる。10

#### 【0081】

したがって、本発明の実施形態において、第1電極450と第2電極460は、電気的に駆動部120及び/又は感知部110に連結されなければならない。この時、タッチセンサパネル100のためのタッチ検出装置は、タッチセンシングIC150としてタッチセンサパネル100の一端、又は、タッチセンサパネル100と同一の平面上に形成されることが一般的である。圧力電極パターン450、460は、任意の方法でタッチセンサパネル100のタッチ検出装置と電気的に連結されてもよい。例えば、圧力電極パターン450、460は、ディスプレイモジュール200に含まれた第2PCB210を用いてコネクタ(connector)を通じてタッチ検出装置に連結されてもよい。例えば、図5に示されたように、第1電極450と第2電極460からそれぞれ電気的に延びる伝導性トレース451及び461は、第2PCB210などを通じてタッチセンシングIC150まで電気的に連結されてもよい。20

#### 【0082】

図9a及び図9bは、本発明の第2実施形態による圧力電極の付着方法を例示する。30  
図9a及び図9bでは、本発明の実施形態による圧力電極450、460がディスプレイモジュール200の下部面に付着される場合を示す。図9a及び図9bにおいて、ディスプレイモジュール200は、下部面の一部にディスプレイパネルの作動のための回路が実装された第2PCB210が示される。

#### 【0083】

図9aは、第1電極450と第2電極460がディスプレイモジュール200の第2PCB210の一端に連結されるように、圧力電極450、460をディスプレイモジュール200の下部面に付着する場合を例示する。この時、図9aにおいては、第1電極450と第2電極460が絶縁層470上に製作された場合を例示する。圧力電極450、460は絶縁層470上に形成され、一体型シート(sheet)としてディスプレイモジュール200の下部面に付着されてもよい。第2PCB210上には、圧力電極パターン450、460をタッチセンシングIC150などの必要な構成まで電気的に連結できるように導電性パターンが印刷されていてもよい。これに対する詳細な説明は、図10aないし図10cを参照して説明する。40

#### 【0084】

図9bは、第1電極450と第2電極460がディスプレイモジュール200の第2PCB210に一体型で形成された場合を例示する。例えば、ディスプレイモジュール200の第2PCB210の製作時に、第2PCBに一定の面積211を割愛して予めディスプレイパネルの作動のための回路だけでなく、第1電極450と第2電極460に該当するパターンまで印刷することができる。第2PCB210には、第1電極450及び第50

2電極460をタッチセンシングIC150などの必要な構成まで電気的に連結する導電性パターンが印刷されてもよい。

#### 【0085】

図10aないし図10cは、本発明の第2実施形態による圧力電極をタッチセンシングIC150に連結する方法を例示する。図10aないし図10cにおいて、タッチセンサパネル100がディスプレイモジュール200の外部に含まれた場合として、タッチセンサパネル100のタッチ検出装置がタッチセンサパネル100のための第1PCB160に実装されたタッチセンシングIC150に集積された場合を例示する。

#### 【0086】

図10aにおいて、ディスプレイモジュール200に付着された圧力電極450、460が、第1コネクタ121を通じてタッチセンシングIC150まで連結される場合を例示する。図10aに例示されたように、スマートフォンのような移動通信装置においてタッチセンシングIC150は、第1コネクタ(connector)121を通じてディスプレイモジュール200のための第2PCB210に連結される。第2PCB210は、第2コネクタ221を通じてメインボードに電気的に連結されてもよい。したがって、タッチセンシングIC150は、第1コネクタ121及び第2コネクタ221を通じてタッチ入力装置1000の作動のためにCPU又はAPと信号をやり取りすることができる。

#### 【0087】

この時、図10aにおいては、圧力電極450が図9bに例示されたような方式でディスプレイモジュール200に付着されたことが例示されているが、図9aに例示されたような方式で付着した場合にも適用されてもよい。第2PCB210には、圧力電極450、460が第1コネクタ121を通じてタッチセンシングIC150まで電気的に連結され得るように導電性パターンが印刷されていてもよい。

#### 【0088】

図10bにおいて、ディスプレイモジュール200に付着された圧力電極450、460が、第3コネクタ471を通じてタッチセンシングIC150まで連結される場合が例示される。図10bにおいて、圧力電極450、460は、第3コネクタ471を通じてタッチ入力装置1000の作動のためのメインボードまで連結され、その後、第2コネクタ221及び第1コネクタ121を通じてタッチセンシングIC150まで連結されてもよい。この時、圧力電極450、460は、第2PCB210と分離した追加のPCB211上に印刷されてもよい。または、実施形態により圧力電極パターン450、460は絶縁層470上に形成され、圧力電極450、460から伝導性トレースなどを延長させてコネクタ471を通じてメインボードまで連結されてもよい。

#### 【0089】

図10cにおいて、圧力電極450、460が第4コネクタ472を通じて直接タッチセンシングIC150に連結される場合が例示される。図10cにおいて、圧力電極450、460は、第4コネクタ472を通じて第1PCB160まで連結されてもよい。第1PCB160には、第4コネクタ472からタッチセンシングIC150まで電気的に連結する導電性パターンが印刷されていてもよい。これにより、圧力電極450、460は、第4コネクタ472を通じてタッチセンシングIC150まで連結されてもよい。この時、圧力電極450、460は、第2PCB210と分離した追加のPCB211上に印刷されてもよい。第2PCB210と追加のPCB211は、互いに短絡しないように絶縁されていてもよい。または、実施形態により圧力電極450、460は絶縁層470上に形成され、圧力電極450、460から伝導性トレースなどを延長させてコネクタ472を通じて第1PCB160まで連結されてもよい。

#### 【0090】

図10b及び図10cの連結方法は、圧力電極450、460がディスプレイモジュール200の下部面だけでなく、基板300上に形成された場合にも適用されてもよい。

10

20

30

40

50

## 【0091】

図10aないし図10cにおいては、タッチセンシングIC150が第1PCB160上に形成されたCOF(chip on film)構造を仮定して説明された。しかし、これは単に例示に過ぎず、本発明は、タッチセンシングIC150がタッチ入力装置1000の実装空間310内のメインボード上に実装されるCOB(chip on board)構造の場合にも適用されてもよい。図10aないし図10cに対する説明から、当該技術分野の当業者に、他の実施形態の場合に圧力電極450、460のコネクタを通じた連結は自明であろう。

## 【0092】

以上においては、駆動電極として第1電極450が一つのチャネルを構成し、受信電極として第2電極460が一つのチャネルを構成する圧力電極450、460に対して詳しく見てみた。しかし、これは単に例示に過ぎず、実施形態により駆動電極及び受信電極は、それぞれ複数個のチャネルを構成して多重タッチ(multi touch)によって多重の圧力検出が可能であり得る。

10

## 【0093】

図11aないし図11cは、本発明の実施形態による圧力電極が複数のチャネルを構成する場合を例示する。図11aでは、第1電極450-1、450-2と第2電極460-1、460-2それが2個のチャネルを構成する場合が例示される。図11bでは、第1電極450は2個のチャネル450-1、450-2を構成するが、第2電極460は1個のチャネルを構成する場合が例示される。図11cでは、第1電極450-1ないし450-5と第2電極460-1、460-5それが5個のチャネルを構成する場合が例示される。

20

## 【0094】

図11aないし図11cは、圧力電極が単数又は複数のチャネルを構成する場合を例示して、多様な方法で圧力電極が単数又は複数のチャネルで構成されてもよい。図11aないし図11cにおいて、圧力電極450、460がタッチセンシングIC150に電気的に連結される場合が例示されなかったが、図10aないし図10c及びその他の方法で圧力電極450、460がタッチセンシングIC150に連結されてもよい。

## 【0095】

図12は、本発明の実施形態によるタッチ入力装置1000のタッチ表面中心部を非伝導性客体で加圧する実験を遂行し、客体のグラム重量(gram force)に伴う静電容量の変化量を表示するグラフである。図12から分かるように、本発明の実施形態によるタッチ入力装置1000のタッチ表面中心部を加圧する力が大きくなるほど、圧力検出モジュール400に含まれた圧力電極パターン450、460の静電容量の変化量が大きくなることが分かる。

30

## 【0096】

以上においては、圧力検出モジュール400として静電容量方式の検出モジュールが説明されたが、本発明の実施形態によるタッチ入力装置1000は、圧力検出モジュール400としてスペーサ層420及び圧力電極450、460を用いる場合であれば、任意の方式の圧力検出モジュールを用いることができる。

40

## 【0097】

以上において実施形態に説明された特徴、構造、効果などは、本発明の一つの実施形態に含まれ、必ずしも一つの実施形態にのみ限定される訳ではなく、さらに、各実施形態において例示された特徴、構造、効果などは、実施形態が属する分野における通常の知識を有する者によって他の実施形態に対しても組み合わせ、又は変形されて実施可能である。したがって、このような組み合わせと変形に関係した内容は、本発明の範囲に含まれるものと解釈されなければならないだろう。

## 【0098】

また、以上において、実施形態を中心に説明したが、これは単に例示に過ぎず、本発明を限定する訳ではなく、本発明が属する分野における通常の知識を有する者であれば、本

50

実施形態の本質的な特徴を外れない範囲で、以上に例示されない様々な変形と応用が可能であることが分かるはずである。例えば、実施形態に具体的に示された各構成要素は、変形して実施することができるものである。そして、このような変形と応用に係る相違点は、添付の特許請求の範囲において規定する本発明の範囲に含まれるものと解釈されるべきである。

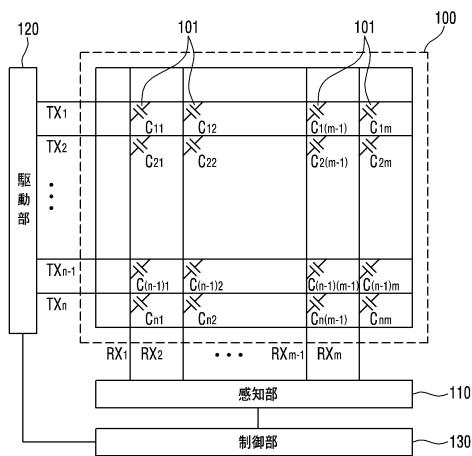
### 【符号の説明】

#### 【0099】

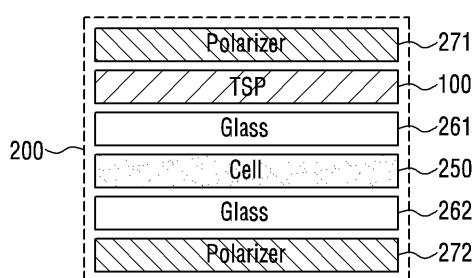
1 0 0 0	タッチ入力装置
1 0 0	タッチセンサパネル
1 1 0	感知部
1 2 0	駆動部
1 3 0	制御部
2 0 0	ディスプレイモジュール
3 0 0	基板
4 0 0	圧力検出モジュール
4 2 0	スペーサ層
4 5 0、4 6 0	電極

10

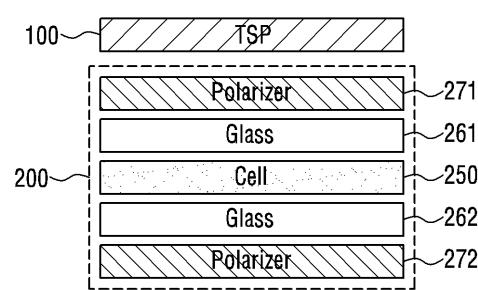
【図1】



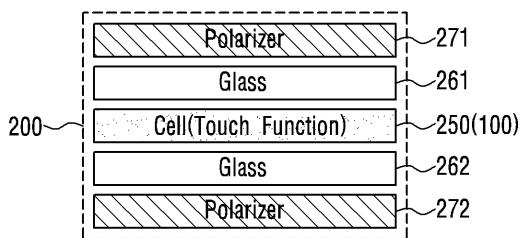
【図2 b】



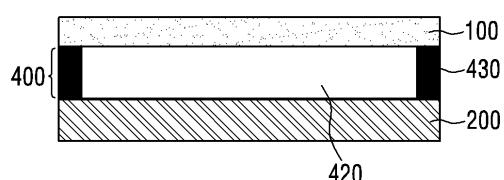
【図2 a】



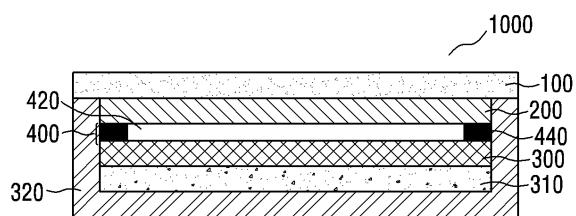
【図2 c】



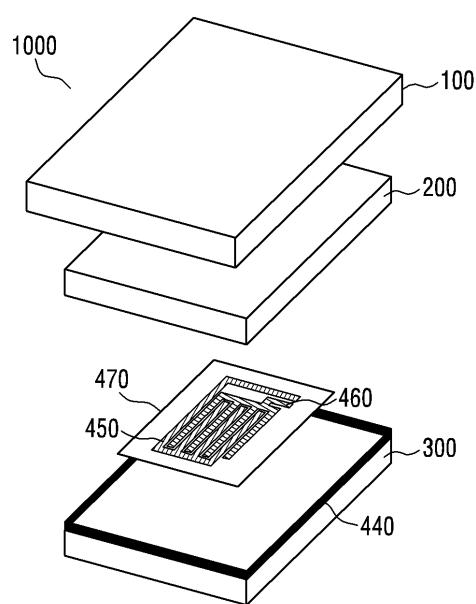
【図3】



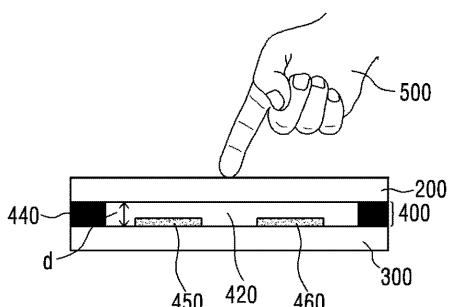
【図4】



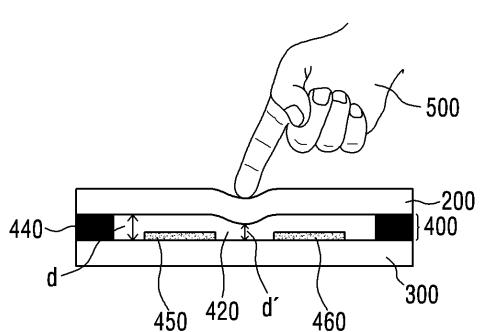
【図5】



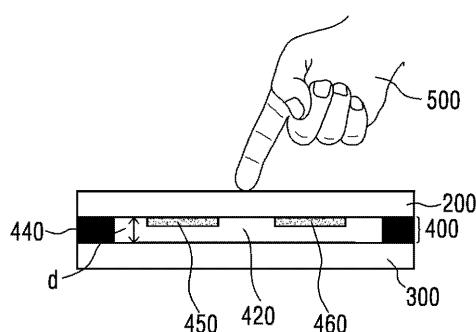
【図6 a】



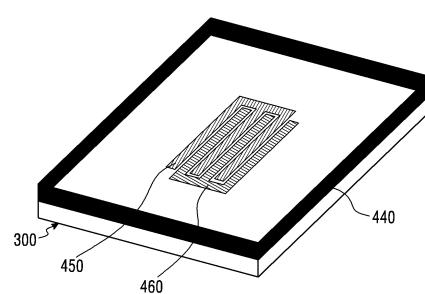
【図6 b】



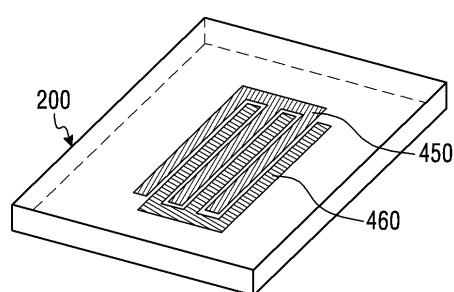
【図6 c】



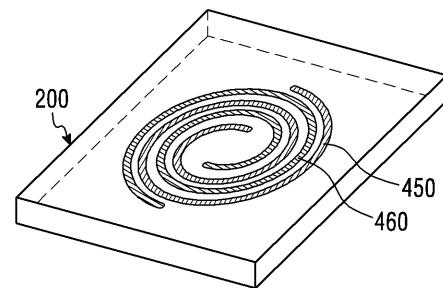
【図6 d】



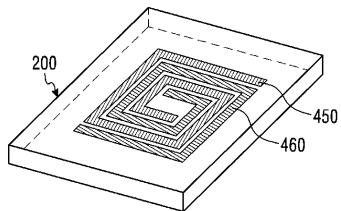
【図 6 e】



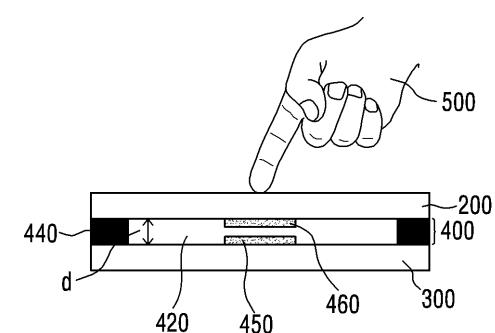
【図 6 g】



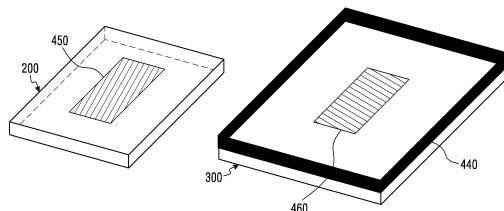
【図 6 f】



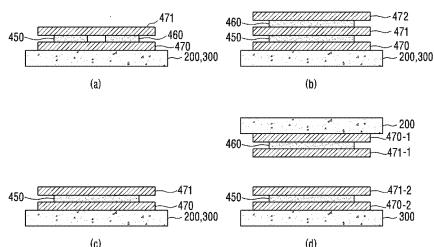
【図 7 a】



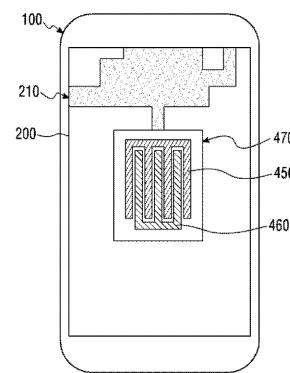
【図 7 b】



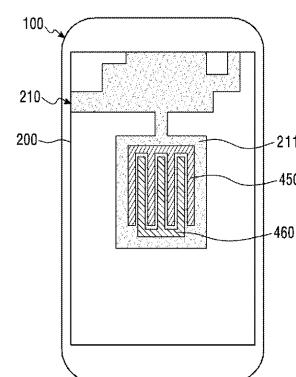
【図 8】



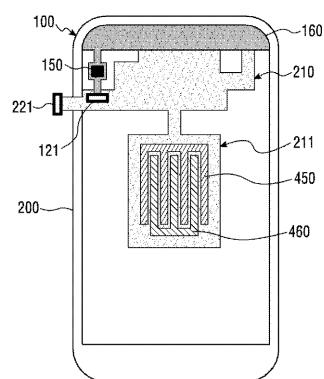
【図 9 a】



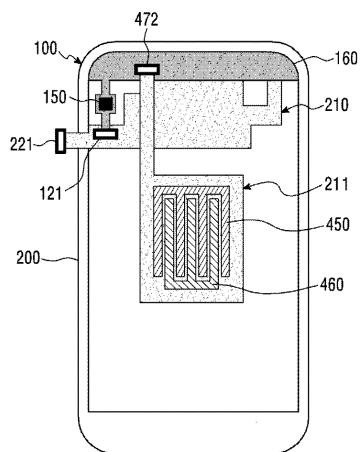
【図 9 b】



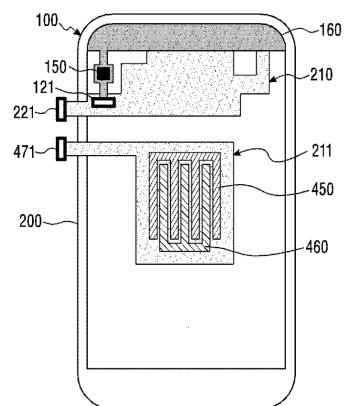
【図 10 a】



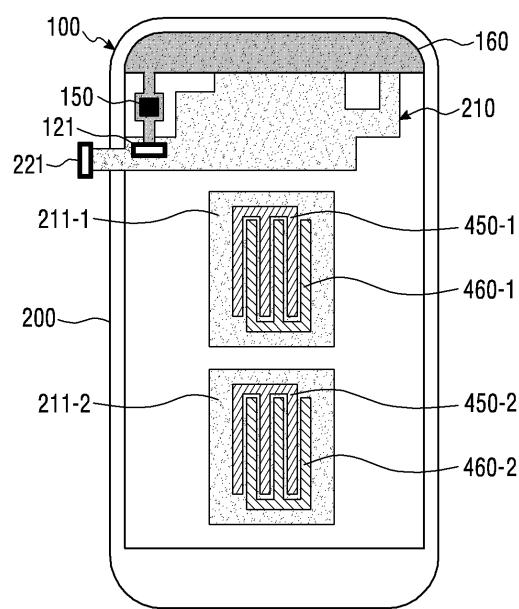
【図 10 c】



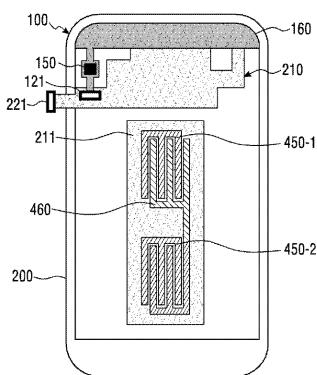
【図 10 b】



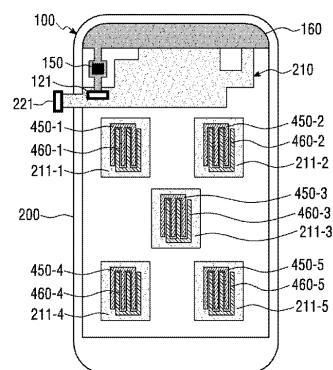
【図 11 a】



【図 11 b】

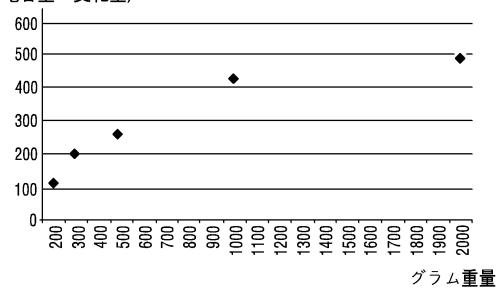


【図 11 c】



【図12】

(静電容量の変化量)



---

フロントページの続き

(74)代理人 100119253  
弁理士 金山 賢教

(74)代理人 100124855  
弁理士 塚倉 道明

(74)代理人 100129713  
弁理士 重森 一輝

(74)代理人 100137213  
弁理士 安藤 健司

(74)代理人 100143823  
弁理士 市川 英彦

(74)代理人 100151448  
弁理士 青木 孝博

(74)代理人 100183519  
弁理士 櫻田 芳恵

(74)代理人 100196483  
弁理士 川崎 洋祐

(74)代理人 100203035  
弁理士 五味渕 琢也

(74)代理人 100185959  
弁理士 今藤 敏和

(74)代理人 100160749  
弁理士 飯野 陽一

(74)代理人 100160255  
弁理士 市川 祐輔

(74)代理人 100146318  
弁理士 岩瀬 吉和

(74)代理人 100127812  
弁理士 城山 康文

(72)発明者 キム・セヨプ  
大韓民国、ギヨンギ - ド・463-400、ソンナム - シ, ブンダン - グ, ダエワンパンギヨ - ロ  
・644・ベオン - ギル(676・サムピヨン・ドン)、49、ダサン・タワー・3エフ

(72)発明者 ユン・サンシク  
大韓民国、ギヨンギ - ド・463-400、ソンナム - シ, ブンダン - グ, ダエワンパンギヨ - ロ  
・644・ベオン - ギル(676・サムピヨン・ドン)、49、ダサン・タワー・3エフ

(72)発明者 ムン・ホジュン  
大韓民国、ギヨンギ - ド・463-400、ソンナム - シ, ブンダン - グ, ダエワンパンギヨ - ロ  
・644・ベオン - ギル(676・サムピヨン・ドン)、49、ダサン・タワー・3エフ

(72)発明者 キム・テフン  
大韓民国、ギヨンギ - ド・463-400、ソンナム - シ, ブンダン - グ, ダエワンパンギヨ - ロ  
・644・ベオン - ギル(676・サムピヨン・ドン)、49、ダサン・タワー・3エフ

## 合議体

審判長 新川 圭二  
審判官 山田 正文  
審判官 山澤 宏

(56)参考文献 特開2011-100364(JP,A)  
登録実用新案第3191884(JP,U)

特開2002-366304(JP,A)  
特開2011-170659(JP,A)  
国際公開第2014/080924(WO,A1)  
国際公開第2011/013588(WO,A1)  
特表2012-502421(JP,A)  
特開2014-29372(JP,A)  
特表2011-518385(JP,A)  
特開平10-97382(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G06F3/041-3/047